平成27年３月９日

各　　位

会 社 名　太 洋 工 業 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　細 江 美 則
（ＪＡＳＤＡＱ・コード：６６６３）
問合せ先
役職・氏名　取締役管理本部長 兼経営企画部長　阪 口 豊 彦
電　　話　０７３－４３１－６３１１

極薄片面ＦＰＣの開発に関するお知らせ

当社は、主力事業である電子基板事業において、別紙のとおり、食品用ラップフィルムと同等の厚さ（最小基板厚10μｍ）の片面ＦＰＣ（フレキシブルプリント配線板）を開発いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社といたしましては、本件が今後の電子基板事業の業容拡大に大きく貢献するものと期待しておりますが、当面の業績に与える影響は限定的であると考えております。

（別紙）プレスリリース資料
「極薄片面ＦＰＣの開発について」

以　上

（別紙）プレスリリース資料

平成27年３月９日

各　　位

会 社 名　太 洋 工 業 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　　細 江 美 則
（ＪＡＳＤＡＱ・コード：６６６３）
問合せ先
役職・氏名　研究開発部次長　　浅 井 頼 明
電　　話　０７３－４３１－６３１１

極薄片面ＦＰＣの開発について

当社は、ＦＰＣ（フレキシブルプリント配線板）において、従来比約75％薄型化（当社比）となるＦＰＣ厚み10μmの「極薄片面ＦＰＣ」を開発いたしました。

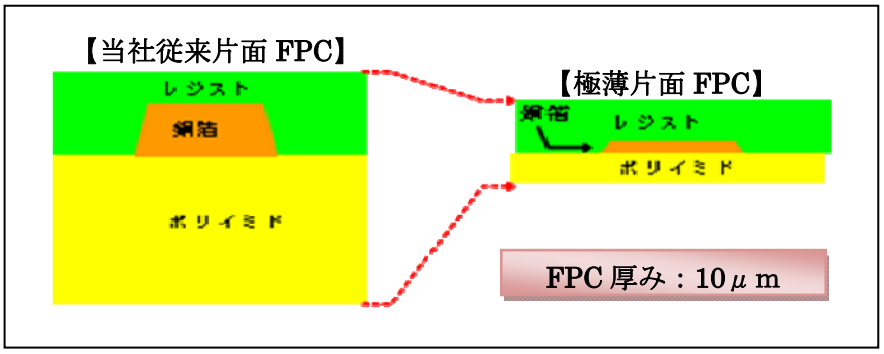
「極薄片面ＦＰＣ」は、医療用ウエアラブル機器で必要とされる基板として開発されました。

極薄化に伴い、柔軟性が向上し従来比約30％軽量化（当社比）されたことにより、人体に装着した際の違和感を大きく低減することが期待できます。

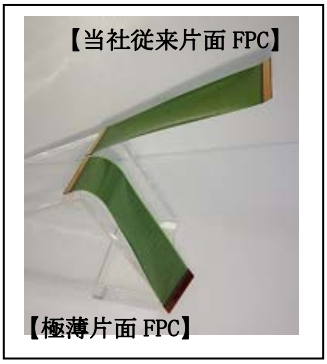
【特　徴】

１．基板厚：最小基板厚10μm（厚さ約75％薄型化（当社比））
２．柔軟性向上（低スプリングバック性）
３．省スペース化・軽量化（重量約30％軽量化（当社比））
（注）重量は回路形状により変化します。

≪極薄化イメージ≫



≪柔軟性比較≫



このＦＰＣは、すでに一部の先端医療開発用途にサンプル出荷を開始しており、今後ウエアラブル医療機器、スポーツ科学分野及びその他軽量・省スペース化の要求される電子機器分野へのサンプル出荷を拡大し、業容拡大を目指してまいります。

【主な用途】

１．次世代ウエアラブル医療機器
２．スポーツ科学用途のウエアラブルワイヤレス電子機器
３．その他、軽量・省スペースの要求される電子機器

以　上